

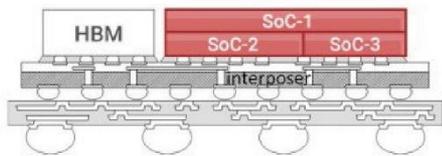


台積電 | 先進封裝營運處 | APOD

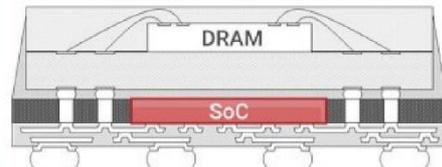
獨佔高端晶片封裝「藍海」

- ▶ 全台灣從北到南，共5座 先進封裝廠
- ▶ 全世界最先進的封裝技術
- ▶ 領先業界的自動化設備
- ▶ 獨創機器學習與資料分析系統
- ▶ 前端設計到後端封裝，一條龍整合服務

超級電腦晶片封裝



高階手機晶片封裝





越過摩爾定律 全世界最先進封裝技術 等你一起加入挑戰



台積電 | 先進封裝營運處 | APOD

- 工作職缺 製程整合(PID)/製程(PE)/設備(EE)/工安環保(ISEP)工程師
物流運籌(AMHS)/自動化整合(CIM)/智慧製造(MFG)工程師
模組副工程師(MAE)
- 工作地點 龍潭/新竹/台中/台南
- 工作經歷 不拘
- 履歷請寄 G_JoinAPOD@tsmc.com
- 有任何問題請聯繫
江彥德
0975-907-952



台積電

先進封裝營運處

APOD

製程工程師(PE)

1. 先進封裝新產品導入為主，將產品設計與製程能力做整合與改進，改善良率
2. 控制線上產品及異常分析
3. 須具備研究所學歷及以上，主要為材料、電子、電機、化學、化工、光電、物理科系以及理工相關背景

設備工程師(EE)

1. 半導體 3DIC 相關機台設備優化及改善，增加機台運作精進與穩定性以及產能提升
2. 先進封裝新機台評估與導入應用
3. 須具備大學學歷及以上，主要為電子、電機、機械、機電、自動化控制、光電以及理工相關背景

先進封裝製程整合工程師(PID)

1. 先進封裝新產品導入為主，將產品設計與製程能力做整合與改進，來改善良率
2. 控制線上產品品質及異常分析
3. 須具備研究所學歷及以上，主要為材料、電子、電機、物理、化學、化工、光電以及理工相關科系背景

模組副工程師(MAE)

1. 負責半導體產品線機台設備維修及保養
2. 管理及改善機台零件系統、包含廠商與下包商之零件備品管理、設計機台保養制具及流程改善以增進機台穩定性
3. 具備大學學歷，且為電機、電子、機械、自動控制、冷凍空調工程等相關科系與具有機械相關的基礎知識

智慧製造工程師(MFG)

1. 大數據分析、提升生產製造效率：透過數據分析，找出瓶頸機台，提升機台生產效率。
2. 突破性的分析派工專案系統，優化生產資源與最佳化製造效率。
3. 機器學習、創造無限可能：利用機器學習的研究方法，應用於生產流程改善，達成生產排程的最佳化以及晶圓產出極大化

工安環保工程師(ISEP)

1. 新建暨運轉廠區安全 / 衛生 / 環保工作之推動與管理，須具備相關證照
2. 新建 / 運轉廠區環安相關專案活動之推動及參與以及承攬商安全管理之規劃與執行
3. 大學以上，職安衛、工安、環工、理工、消防 ... 等相關科系畢業，且具備乙級勞工安全衛生管理員證照與消防相關執行經驗

自動化物流運籌工程師(AMHS)

1. 負責半導體生產線 AMHS 自動傳送設備維護及保養
2. 管理及改善自動傳送系統營運效能及穩定運作
3. 具備碩士學歷，且為電機、機械、交通運輸、工工、資工等相關科系或作業研究相關的基礎知識

自動化整合工程師(CIM)

1. A.I. 專案建構設計開發
2. 自動化資訊系統設計開發
3. 具備碩士學歷，且為資工、電資、資管等相關科系與具有 Python, Java, .Net, Database 相關的基礎知識